

令和7年8月22日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会  
会長 嶋田 勇三

## 第234回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第234回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。

今回は会場とWEB会議システム（Zoom ウェビナー）を利用したハイブリッド開催となります。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時：令和7年9月18日（木）定例講演会 12：50～16：45  
技術交流会 17：00～18：00

2. 開催方式：ハイブリッド方式

【川崎市産業振興会館第4会議室+WEB会議システム「Zoom ウェビナー」】  
（Zoom参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします）  
川崎市産業振興会館：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20  
<https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/>

3. プログラム：“電子部品の信頼性と測定技術”

(1)12:50～13:35 プログラムテーマ①	『X線による実装基板の不良解析 不良を造らないために、多くの不良事例から学ぶこと』 (株) アイビット 代表取締役 向山 敬介 氏 講演内容：実装基板の不良事例を X線装置を用いて解析する方法について解説する。不良事例ごとに不良形状も変わる。不良基板を X線画像で解析することで、発生の原因が判る事例も多くある。最新の X線検査手法と合わせて、X線による不良解析方法、不良原因の特定方法などを紹介する。今回取り上げる不良事例 (1) 基板内層 Via の気泡による不良 (BGA を上から押すと正常動作) (2) 基板スルーホールクラックによる不良 (炉内で過熱膨張してクラックが入る、炉から出て不良となるため実装不良と思われる) (3) 部品反り、基板反りによる「まくらはんだ」不良 (炉内での熱膨張による反り) (4) 基板穴埋め不良により、炉内加熱時に Via からの吹き出し不良 (Via の加熱膨張) (5) BGA と基板接合部の面積比率の違いによる不良 (駆動熱でボールが膨張する際に接続面積が小さい側にクラック発生)
(2)13:35～14:20 プログラムテーマ②	『3次元実装等の実装分野における検査・測定機メーカーとしての視点とソリューションの紹介』 レーザーテック (株) 第一ソリューションセールス部 雨宮 恭平 氏 講演内容：生成 AI の普及により HBM 等の新たなデバイス構造が開発されているが、メモリだけでなく NAND やロジック分野においても 3次元集積技術が活用され始めている。各デバイスのプロセスが変化すると共に新たな検査・検査ニーズが生じている。本講演では Advanced package 分野における新たな測定ニーズと Lasertec 社が提供するソリューションを紹介する。
(3)14:20～15:05 プログラムテーマ③	『IPC トレーニングと認証資格、監査、委員会について』 (株) ジャパンユニックス IPC ユニット課長 鈴木 勉 氏 講演内容：世界中の産業の合意に基づいて策定された標準規格である IPC は、現在、多くの海外取引でこの標準への準拠が求められている。グローバル化が進む日本企業も例外ではなく、製造工程における IPC 準拠の証明として、認定保有者による工程管理や作業実施が要件となるケースが増えている。本講演では、IPC 認証資格の意義と取得方法、トレーニングの具体的な内容、工場監査における IPC の役割、さらに日本国内における IPC 委員会の活動について紹介する。
15:05～15:15	— 休憩 —

<p>(4) 15:15～16:00 プログラムテーマ④</p>	<p>『大気圧プラズマ技術による実装品質・信頼性改善～Openair-Plasmaの最新事例～』 日本プラズマトリート（株）セールス&amp;アプリケーションプリセールス 三好 永哲 氏</p> <p>講演内容：現代における精緻で高機能な工業製品では、各材料表面の清浄度を向上させ、次工程のために最適な表面状態を均一に確保することが、品質、耐久性、機能性の確保に不可欠である。特に半導体・電子機器製造では、微細な残留物に加え、金属酸化膜の存在が製品の信頼性に影響を与えるため、高度な表面処理技術が求められている。同社の革新的な技術である「Openair-Plasma（オープンエアープラズマ）」や「HydroPlasma（ハイドロプラズマ）」は既存ラインへの導入も可能なインラインプロセスとして、最高水準の清浄度を実現する。さらに、「PlasmaPlus（プラズマプラス）」技術は、基材に新たな機能性表面を生成することで、接合信頼性の向上だけでなく、防湿や防錆といった機能性向上を可能とする。またこれらのプラズマ技術は危険な化学薬品を一切使わず、全てVOC（揮発性有機化合物）フリーであり、環境負荷の低減を両立する。本講演では、従来の処理工程に代わる画期的な表面処理技術として、同社の大気圧プラズマを活用した各技術のメカニズムと特長を解説し、電子機器・半導体製造における最先端の活用事例や導入メリットを具体的に紹介する。</p>
<p>(5) 16:00～16:45 プログラムテーマ⑤</p>	<p>『プリント配線板の信頼性向上にむけた測定技術』 日置電機（株）プロダクト&amp;マーケティング本部 X部 山崎 浩 氏</p> <p>講演内容：プリント配線板ではオープン不良とショート不良を見つけることが、長らく検査の中心となっていた。しかし、従来の検査だけでは、検査時に良品だったプリント配線板が、部品を実装した後の動作試験で不良となったり、市場に出てしばらくしてから不良となったりしてしまうという事例があった。このような潜在不良を出荷検査で発見するため、同社ではパターンの抵抗を精密に測定する技術を用いた検査装置を開発し、信頼性の向上に寄与してきた。本講演では、信頼性向上のための測定技術をハード、ソフトの両面から紹介する。</p>
<p>17:00～18:00</p>	<p>－ 技術 交 流 会 － 産業振興会館 2階「カフェサウダージ」にて</p>

#### 4. 参加費

会 員：無料 企業正会員は1社3名まで（Web会議特例：3名を超える参加者については事務局にお問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1登録1名様のご利用でお申込みください。  
会員外：22000円/人（不課税）（お申し込み後、請求書をお送りします）

#### 5. 参加申し込み

会 員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いいたします。

※今回、会場とZoomウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

会員外：ホームページのお問い合わせフォーム（<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>）より「お問い合わせ内容」の項目に「第234回定例講演会参加希望」と参加方式（会場もしくはZoom）をご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前とE-mailアドレスもご記入ください。

申込締切日：会 員 令和7年9月9日（火）

会員外 令和7年9月5日（金）

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoomウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※今年度から講演資料は、当会ホームページの会員のページ（<https://www.j-jisso.org/member/>）に講演日までにアップいたします。IDとPWが必要ですので講演日前までにご確認ください（企業正会員は貴社連絡担当者にご確認下さい）。今年度より資料の郵送はいたしません。

会員外の方はクラウドで資料共有をいたします。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会 事務局  
E-mail : [info@j-jisso.org](mailto:info@j-jisso.org) ※E-mail アドレスが変わりました  
URL : <http://www.j-jisso.org>